

Quality Puzzle

- 자주검사 및 SPC 전산화
- 신속대응 FR 회의
- 공정 변경관리 M-Card
- Tool 교체 이력관리
- 부적합품 관리

Process

- 조립부 치수 검증
- Lay-out Audit
- 외관 품질 관리
- 신뢰성 시험

Product

- 자동보정장치 측정 편차 분석
- Gage 검교정 현황 전산화
- 측정 System 분석
- 정밀 측정기기 관리

Measurement

- 추적성 Lot 관리
- LPA 계층적 공정감사
- P C P A
(Process Control Plan Audit)
- 품질 System 평가

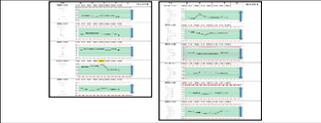
System

PPMS 18 Activities

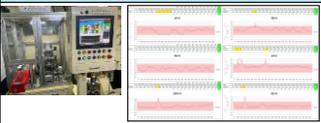
Process

자주검사 및 SPC 전산화	신속대응 FR 회의	공정 변경관리 M-Card	Tool 교체 이력관리	부적합품 관리
				
공정 내 PC 설치 및 네트워크를 통한 SPC 실시간 모니터링 관리중	전일 발생한 고객/공정/외주 품질 문제를 매일 아침 9시에 현장 회의 진행	공정 내 발생하는 4M 변경 사항을 초,중,종 이력관리 실시	가공 공정 특성에 맞춰 일일 Tool 교체 검증 이력 전산 관리	공정 및 소재 불량 유출/혼입 예방을 위한 일일 격리 및 전산 이력관리 실시

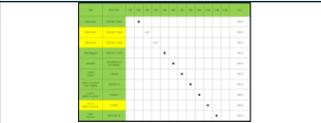
Product

조립부 치수 검증	Lay-out Audit	외관 품질 관리	Reliability Test
			
고객사 주요 특별특성 항목 및 조립부 가공 치수 주1회 Trend 분석	주요 특별특성 항목 외 도면 전치수 1회/월 모니터링 실시	최종 검사 공정 운영 외관 및 게이지 전수검사 후 포장 진행	내구성 및 시험편 분석을 위한 공인기관 측정의뢰 (1회/6개월)

Measurement

자동보정장치 측정 편차 분석	Gage 검교정 현황 전산화	측정 System 분석	정밀 측정기기 관리
			
E/P 장치 및 자동 측정 장비 ↔ CMM 측정 편차 주1회 분석(10 μ m 이내 관리)	월간 검교정 대상기기 전산화 관리 검교정 누락 방지	년간 특별특성 항목 측정 Gage R&R 계획 대비 실적 관리	CMM/형상측정기/조도기/경도기/투영기 외 년간 KOLAS 인증기관 검교정 의뢰

System

추적성 Lot 관리	LPA 계층적 공정감사	PCPA (Process Control Plan Audit)	품질 System 평가	인증 현황 유지 관리
				
공정이동전표를 통한 소재/가공/표면처리 Lot별 포장 및 출하이력대장 전산 관리	전 계층별 공정 감사 진행을 통한 공정 표준 작업 준수	년간 공정별 관리항목 표준주 일치화 점검 계획 대비 실적 관리	년 1회 공정 품질 System 평가 진행	IATF16949 / ISO14001 BIQS(GM) / SSQ(쌍용) 인증 유지 관리